

## 2018 年頡邦科技校外實習計畫(一年期)

公司名稱	頡邦科技股份有限公司				
負責人	吳非艱	統一編號	16130009		
聯絡人	余小姐	部門	人力發展部		
聯絡電話	(03)567-8788 #22303	傳真	(03)567-8690		
公司地址	(總部) 新竹市力行五路三號				
E-mail	<a href="mailto:mandyy@chipbond.com.tw">mandyy@chipbond.com.tw</a>				
公司簡介	<p>頡邦科技公司成立於 1997 年 7 月，為利基型的半導體封裝與測試服務供應商，主要業務為提供顯示器驅動 IC 後段封裝及測試代工服務，其中驅動 IC 封裝包括前段之金凸塊製程與後段之 TCP 及 COG 封裝，及覆晶封裝並包括前段之錫鉛凸塊製作。</p> <p>2010 年合併案後，在金凸塊、Wafer test、COF、COG 的產能為全球第一大，目前為全球第一大驅動 IC 封裝公司。</p>				
營業項目	<p>◎營業項目</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 金屬凸塊(Wafer Bumping Service)</li> <li>(2) 金凸塊(Gold Bump)</li> <li>(3) 錫鉛凸塊(Solder Bump)</li> <li>(4) 捲帶式軟板封裝(TCP)</li> <li>(5) 捲帶式薄膜覆晶(COF, Chip on Film)</li> <li>(6) 覆晶(Flip Chip)</li> <li>(7) 玻璃覆晶封裝(COG, Chip on Glass)</li> </ol> <p>◎產品營收比重分別為：</p> <p>8 吋金凸塊約佔 29%、12 吋金凸塊約 12%、晶圓測試約佔 1 成，COF(捲帶式覆晶薄膜封裝)約佔 22%、COG(玻璃覆晶封裝)約佔 10%、Tape(COF 載板)約佔 16%。COF 因可重封，其主要應用於大尺寸面板，COG 則多用在小尺寸面板。</p> <p>◎以應用分：</p> <p>TV 佔約 45%、手機佔約 25%、平板電腦佔約 10、PC 及 NB 佔約 25%。</p>				
資本額	65 億元	年營業額	172 億元	員工人數	5500 人(台灣)

## 實習資訊說明

實習系列 /地點	工作項目	名額
理工科系 (新竹地區)	<p><b>※設備類</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.半導體機台維護與保養</li> <li>2.現場機台異常排除</li> <li>3.治工具維護</li> </ol> <p><b>※製程類</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.製程穩定性監控與維護</li> <li>2.製程異常排除與改善</li> <li>3.工程實驗與資料蒐集分析</li> </ol> <p><b>※產品類</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.新產品 Setup Run</li> <li>2.新產品參數確認</li> <li>3.工程品異常分析及處理</li> <li>4.協助專案執行</li> </ol> <p><b>※生產實務類</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.機台操作</li> <li>2.顯微鏡目檢</li> <li>3.包裝生產等協助</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.設備類、製程類、產品類，共 15 名。(需輪班)</li> <li>2.生產實務類，共 30 名。(固定班別)</li> </ol>
理工科系 (高雄地區)	<p><b>※設備類</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.半導體機台維護與保養</li> <li>2.現場機台異常排除</li> <li>3.治工具維護</li> </ol> <p><b>※製程類</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.製程穩定性監控與維護</li> <li>2.製程異常排除與改善</li> <li>3.工程實驗與資料蒐集分析</li> </ol> <p><b>※生產實務類</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.機台操作</li> <li>2.顯微鏡目檢</li> <li>3.包裝生產等協助</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.設備類、製程類，共 10 名。(需輪班)</li> <li>2.生產實務類，共 40 名。(固定班別)</li> </ol>
商管或語文 相關科系 (新竹地區)	<p><b>※品保、客服類</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 文書處理</li> <li>2. 國外客戶接待與翻譯</li> </ol> <p style="color: red;">(英語、韓語或日語精通，需檢附語文認證)</p>	5 名(常日班，周休二日)
資工、資管 相關科系 (新竹地區)	<p><b>※資訊科技類</b></p> <p>維護 MES 相關系統</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.熟悉 VB/C#.Net/ASP.NET 等開發工具</li> <li>2.具備資料庫基本觀念(Oracle PL/SQL)</li> <li>3.了解 MES 系統(SmartFactory/Factoryworks 尤佳)</li> <li>4.有自動化 SECS/GEM 系統經驗尤佳</li> </ol>	4 名(常日班，周休二日)

<b>訓練與管理</b>	1. <b>實習地點：新竹科學園區(新竹市)、新竹工業區(新竹縣湖口鄉)、高雄前鎮加工出口區。</b> 2. <b>一年期全時實習</b> (學分需先修畢)，須配合實習工作需求安排班別。 3. 實習生除比照正式員工，於報到時接受新進人員訓練外，實習部門將視工作需要給予必要之訓練。 4. 實習生於實習期間須遵守公司之相關管理規定、請假、加班、門禁管理及行為規範等。 5. 實習期間將安排輔導人員從旁協助實習生工作學習；除此，亦會定期舉辦實習座談會了解同學實習狀況。 6. 於實習結束前，須參加成果發表會進行實習心得報告，作為校外實習成績與留用參考依據。		
<b>薪 資</b>	■做四休二，月薪日班 30,000 元起、夜班 38,000 元起 ■常日班，月薪日班 22,500 元起。		
<b>膳宿狀況</b>	■公司提供午、晚餐及宵夜餐 (個人負擔 25 元/餐) ■公司提供外縣市同仁宿舍 (1,500 元/月。宿舍前三個月免費-2 人房)		
<b>提供保險</b>	■勞保    ■健保    ■團體保險		
<b>工作時間</b>	■日班：07:20~19:20，輪休 ■夜班：19:20~07:20，輪休 ■常日班：08:30~17:30，周休二日		
<b>加班情況</b>	<input type="checkbox"/> 不必加班 <input checked="" type="checkbox"/> 偶而 <input type="checkbox"/> 常態性加班	<b>預估每月平均須加班時數</b>	依需求調整，非固定
<b>福利制度</b>	(1) 報到第一天即加保勞保、健保、團保，提供完整的工作保障。 (2) 提供冷氣宿舍，二人一室每月 1500 元，前三個月免費(電費另計)。 (3) 提供實習獎助學金最高 <b>40,000 元</b> 。固定夜班者，期滿另享特別獎金。 (4) 提供公司內部用餐補助、便利商店員工優惠折扣等福利。 (5) 獎勵實習生勇敢踏入職場學習，提供獎助學金，並期勉同學能夠儘早取得就業入場券。 (6) 鼓勵實習生優良表現，畢業後持續留用碩邦， <u>年資續計並提供高額留用獎金</u> 給予嘉勉。 (7) 實習屆滿前，舉辦成果發表會，協助職涯發展與提供內部轉任機會。		
<b>申請方式</b>	請填寫「碩邦科技候選人履歷表(實習生)」，掃描或郵寄檔案至承辦人 <u>余小姐</u> 收 (mandy@chipbond.com.tw);後續將電話通知面試時間，進行實習甄選。		

## 碩邦科技候選人履歷表（實習生）

本公司將依照個人資料保護法蒐集、處理與利用您以下所提供的個人資料。詳細資訊請參照本履歷表最末頁之說明。

A. 基本資料										
姓名						國籍	<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> _____			
身分證編號						E-mail				
通訊處	□□□□					電話	(家中): (手機):			
B. 教育、專長										
學位	校名	科系	學制		就學期間		畢業			
			日校	夜校	起	迄	是	否		
大學					年 月	年 月				
碩士					年 月	年 月				
◎ 專業或資格證照										
專業證照或檢定證書			發照日		專業證照或檢定證書			發照日		
(1)					(2)					
C. 工作經驗										
服務期間	服務機構 及 服務部門/職稱	工作內容	薪資	(欲) 離職原因	與應徵職務相關程度 由面談主管: _____ 勾選 * 應徵者請勿填寫 *					
1	年 月~ 年 月				<input type="checkbox"/> 相關 <input type="checkbox"/> 部分相關 <input type="checkbox"/> 不相關					
		/								
2	年 月~ 年 月				<input type="checkbox"/> 相關 <input type="checkbox"/> 部分相關 <input type="checkbox"/> 不相關					
		/								
D. 個人簡述										
1. 請簡述您的家庭狀況：										
2. 請簡述您的個性及嗜好：										
3. 您喜歡擔任任何種職務？您最得意的專長為何？										
4. 您應徵本公司的主因是？										
5. 對於工作，您一心追求的是？為什麼？（追求例如：薪資/成就感/穩定性/挑戰性.....等）										
6. 與人相處時如發生衝突，您將如何反應？您處理的步驟為何？										
7. 請簡述在過去(求學或工作)經驗中最具成就感的事？為什麼？										

<b>E.其他</b>			
目前是否有親戚或朋友在頤邦任職？ <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，姓名_____ 關係_____ 部門_____ 職稱_____			
將來如有加班需求(晚間或假日)，您是否可以配合？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：_____		將來如需與同事輪流值班(晚間或假日)，您是否可以配合？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：_____	
未來三年是否有【出國深造/國內進修】的計畫？ <input type="checkbox"/> 是，請說明之_____ <input type="checkbox"/> 否		公司宿舍	<input type="checkbox"/> 是，需申請 <input type="checkbox"/> 否
		素食餐飲	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

請應徵者完整填寫以上各項欄位

**F.選填資訊：**以下資訊可依個人意願填答。依據就業服務法，頤邦科技提供求職者公平的求職機會。

出生日期	年      月      日	性別	<input type="checkbox"/> 女 <input type="checkbox"/> 男	照片
婚姻狀況	<input type="checkbox"/> 未婚 <input type="checkbox"/> 已婚 <input type="checkbox"/> 離婚 <input type="checkbox"/> 喪偶			
懷孕狀況	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，週數：_____週			
兵役狀況	<input type="checkbox"/> 未役 <input type="checkbox"/> 免役，原因：_____ <input type="checkbox"/> 役畢，軍種：_____，期間：_____			

◎您是否具有以下之法定身分?(頤邦科技歡迎具有以下法定身份之求職者求職。)

原住民     身心障礙者(類別：\_\_\_\_\_)

◎家庭狀況:父母、監護人、配偶、子女及兄弟姐妹

關係	姓名	任職機關及職務	關係	姓名	任職機關及職務
父			配偶		
母			子女		
兄弟姐妹					
緊急聯絡人		緊急聯絡電話			

◎本人承諾上表內所填各項資料皆為屬實，謹此授權頤邦科技得就本人於此履歷表中所提供之陳述與個人資料內容之正確性進行確認。本人充分瞭解在此履歷表中所為之一切陳述如有虛偽不實，願依勞基法第 12 條第一款及刑法偽造文書之相關罰則辦理。

◎本人並特此同意及授權頤邦科技及其關係企業、頤邦科技及其關係企業之職工福利委員會所委託之第三人為招募聘用、人事管理及業務執行之目的，在符合個人資料保護相關法令之範圍內，蒐集、於國內與國際間處理、利用本人已經提供及未來將提供的個人資料。

◎本人已詳閱上開內容，並確認本人已瞭解且已依個人資料保護法及相關法令之規定受告知本人人事資料表內個人資料之蒐集目的、個人資料類別、利用之期間、地區、對象及方式、依個人資料保護法第三條規定得行使之權利及權利行使方式、及不提供本人本履歷表內個人資料時將對本人權益之影響。

填寫人簽名：\_\_\_\_\_

日      期：\_\_\_\_\_